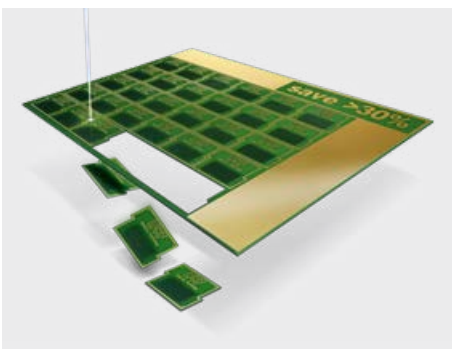


# Mit der nächsten Generation neue Maßstäbe setzen Nutzentrennen mit dem LPKF CuttingMaster 2000

- Herausragende Performance
- Bestmögliche Kosteneffizienz
- Integrierte Tensor-Technologie



# Performance, Effizienz und disruptive Technologie: Maximaler Ertrag durch neue CuttingMaster 2000-Generation

Die neuen, eigens entwickelten Laserquellen sowie eine patentierte Strahlablenkungstechnologie sind weltweit einzigartig und übertreffen mit ihrer Performance sogar die bisherigen, bewährten Systeme der CuttingMaster 2000-Plattform. Für Anwender ermöglichen sie damit einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung.

## Erhöhte Performance zu gleichbleibendem Preis

Im Vergleich zu den Vorgängersystemen kann die Performance durch den Leistungszuwachs um bis zu 25 % gesteigert werden – bei gleichem Invest. Die Wirtschaftlichkeit des Systems wird damit für ein noch breiteres Anwendungsspektrum hochinteressant, insbesondere für das Bearbeiten dickerer Substrate.

## Weiter optimierte Kosteneffizienz

Das optimale Preis-Performance-Verhältnis wird ergänzt durch deutlich verringerte Folgekosten beim Betrieb des Systems. Denn LPKF konnte die zu erwartende Lebenszeit der Laserquelle um 25 % auf bis zu 30 000 Stunden erhöhen. Zudem wurde das Wartungskonzept optimiert, sodass ein zwischenzeitlicher Dioden-Wechsel komplett entfällt und damit über den Lebenszyklus weitere Kosten reduziert werden.

## Gamechanger: Tensor-Technologie

Beim Tensor handelt es sich um eine patentierte ultraschnelle Strahlablenkungstechnologie. Insbesondere beim LPKF CleanCut, dem technisch sauberen Schneiden von Leiterplatten, ermöglicht die Technologie Reduktionen der Zykluszeiten von bis zu 70 %.

## Fazit

Die Kombination der neuen grünen Laserquelle mit der einzigartigen Tensor-Technologie in den neuen Systemen setzt hinsichtlich Performance, technischer Sauberkeit und Effizienz neue Maßstäbe für das Nutzentrennen.

Für Anwender, die zunächst ein besonders kosteneffizientes Einstiegsmodell mit hervorragenden Leistungsdaten suchen, ist der LPKF CuttingMaster 2122 das System der Wahl.

LPKF CuttingMaster	2000 P (manuell)	2000 Ci (automatisiert)
Max. Arbeitsbereich (X x Y)	350 mm x 350 mm	350 mm x 250 mm
Positioniergenauigkeit	± 25 µm	
Durchmesser fokussierter Laserstrahl	~ 20 µm	
Systemabmessungen (B x H x T)	875 mm x 1510 mm x 1125 mm*	
Gewicht	~ 450 kg	
Optionale Features	Universale Fixture-Lösungen, MES-Anbindung, optimierte Absaugung, Ununterbrochene Stromversorgung (USV)	

\* Höhe inkl. Statusampel: 2070 mm

Neue Systemvarianten	CuttingMaster 2122	CuttingMaster 2240
Laserleistung	22 W	40 W
Wellenlänge	355 nm (UV)	532 nm (GR)
Pulsdauer	Nanosekunde	Nanosekunde
CleanCut-Technologie	•	•
Tensor-Technologie	–	•

